

**2023年6月期 WEB 決算説明会（2023年8月8日開催）****およびアナリストミーティングの主な質疑応答**

2023/8/17	初版
2023/8/25	4. を追記

**【新中期経営計画】****1. 前中期経営計画はどのような評価で、新中期経営計画ではなにを目指しているのか？**

A: 半導体・電子等に開発投資を集中した結果、成長ドライバーとなって、中計最終年度である 23/6 期売上高は 2,275 億円となり、当初計画の目標売上高 2,100 億円を上回った。

また、22/8 に上方修正した 23/6 期の売上高計画 2,500 億円に対して、受注高は 2,472 億円となり、受注高ではほぼ達成した。これは市場を捉えた開発やビジネス展開が計画通りに実現したと考えている。

一方、部品長納期化の影響で①受注に対して売上進捗が低水準であったこと、②モノづくり力強化による利益率改善成果が低減し、利益率目標は未達となるなど課題が残った。

新中期経営計画では、中長期的に拡大・成長が期待される半導体・電子やバッテリーなど成長機会が広がっている中、前中計で着実に向上した成長戦略・市場競争力によって、これらの成長機会を生かすことができる。

成長を確実なものとするため計画的生産への移行を中心としたモノづくり力強化による生産性向上による利益率改善と 3,000 億円生産体制構築を推進し、売上高 3,000 億円、売上総利益率 35%、営業利益率 16%を実現する。

**2. 投資環境はどのように捉えているのか？**

A: スマート社会化・デジタル化・メタバースなどに生成 AI の活用が加わり、データ量・解析量・通信量の飛躍的な増加が見込まれている。また、EV シフトの動きも加速している。これらを実現するためには、サーバーやセンサー、各種デバイスの技術革新や増産が必要となる。一方、これらは非常に大きな電力を消費するため、半導体の微細化や各種電子デバイスの省エネ化、パワーデバイスの効率性向上、バッテリーの長寿命化や効率性向上により、エネルギー効率・蓄電効率アップによるグリーンエネルギー化の取組みも求められる。

当社の真空技術により、こうした社会的課題解決に貢献しつつニーズに応えることで、ビジネスチャンスを生かしていきたい。

米中貿易摩擦などを背景とした各国政府支援による半導体工場誘致などの地域サプライチェーン構築の動きも投資環境としてプラスとなっている。

**3. モノづくり力強化の取り組みは前中期経営計画となりが違うのか？**

A: 前中期経営計画では、利益率改善に向けて設計段階からモノづくり力強化に取り組んできた。22/6 期 2Q には売上総利益率 32.4%まで改善したが、部品長納期化等により、効果が低減し目標には届かなかった。

従来は FPD ビジネスが中心であり半導体電子も含めて受注生産で対応していたため、部品長納期化への対応が遅れた面があった。

23/6 期からは半導体やパワーデバイスなど標準化しやすい装置を中心に計画的生産体制に順次シフトすることで納期リードタイムを短くするなど成果が見え始めた。

新中期経営計画では、標準化が進んでいるロジック・メモリなどの半導体やパワーデバイスに加え、同じように標準化対応可能なバッテリービジネスなどの成長ドライバーで計画的生産をさらに拡充していく。

計画的生産拡充により、製品企画力強化の効果がより発揮しやすくなり、生産の平準化による生産性向上や戦略購買強化などの効果が出やすくなり、利益率改善につなげることができる。

## ※8/25 追記

### 4. 計画的生産の対象となる半導体・電子・FPD 装置のうち、どの程度の割合が計画的生産に移行するのか？

A: 20/6 期はまだロジック分野に参入当初で規模も小さく、メモリだけでは計画的生産体制に適した規模とは言えない状況であり、パワーデバイスもまだ小規模で同様の状況だった。

23/6 期にはロジックが成長し、ロジック・メモリ合計で 320 億円強、パワーデバイスも 280 億円弱となり、計画的生産ができる規模に成長してきた。

新たな成長ドライバーとなるバッテリー関連も計画的生産を行っていくので、26/6 期は半導体・電子・FPD 装置ビジネスにおける計画的生産の割合は 65%程度まで高まる見込み。(別紙 2 の通り)

計画的生産体制に移行する中で、製品企画力強化や戦略的購買力強化、生産性向上などモノづくり力強化の取組みの効果をより発揮できるようになると考えている。

### 5. 売上総利益率 35%をどのように実現するのか？

A: 計画的生産移行によるモノづくり力強化への取組みに加え、半導体・電子・バッテリー等の成長ドライバーが貢献することによる売上高増加や相対的に利益率の高い半導体・電子・コンポーネントが増加することによるミックス改善等で、売上総利益率 35%を目指す。

### 6. 部品長納期化の状況は？

A: 部品長納期化は改善してきている。

残る一部の長納期部品については、計画的生産、先行手配などにより納期短縮の成果が出ている。

### 7. 半導体ロジック・メモリの成長戦略は？既存工程・新規工程・新規取引先などに分けて教えてほしい

A: ロジックは EUV に関連した MHM 工程に加えて、前期に実現した新工程参入分も徐々に貢献してくる。他の新工程参入機会もあり、新中期経営計画期間中に工程数を増やしていく。

また、前期に新規取引開始したレガシー半導体の投資継続や米国等地域サプライチェーン構築のための最先端投資活発化等により成長継続見込み。

メモリは足元、半導体メーカーの在庫調整に時間がかかっているが、2024 年からの投資回復を見込んでいる。メモリ分野でも新工程参入の機会が広がっており、市場を上回る成長を目指す。

半導体全体では 3 年間で 23/6 期の 1.6 倍に成長する計画。

### 8. 米国による中国半導体輸出規制等の影響は？パワーデバイス等に影響は無いのか？

A: 中国への半導体輸出規制の影響は、前期に受注を期待していた 50 億円程度にとどまる。

ビジネスの拡大を期待しているパワーデバイスや各種電子デバイス、バッテリーは規制の対象外でビジネスへの影響はない。

むしろ先端半導体投資に制約がある中、パワーデバイス等に対する投資により力が入ってきている感もあり、パワーデバイス等の投資は活発化している。

**9. 中国の不動産市況悪化や景気減速の影響で地方政府の補助金やパワーデバイス等の投資姿勢に変化はないか？**

A: 地方政府のパワーデバイス等に対する補助金等の姿勢が変わったという話は聞かない。  
中国のパワーデバイス等の投資は引き続き活発で、むしろ景気対策的な面もあるのではないと思われる。

**10. パワーデバイスの成長戦略は？分野・地域・装置別の成長戦略を教えてください**

A: パワーデバイスは SiC 投資のウエイトが増していく。従来は中国中心だったが、日本でも SiC 投資が増加傾向にあり、8 インチへのウェハーサイズアップを機に従来からのスパッタ装置に加え、中国で高シェアを確保している SiC 用の温度調整機能に優れたイオン注入装置も拡販していく。

SiC のトレンチ構造への変化に伴い増加するエッチング工程に対応するため、得意とする化合物のエッチングでもシェアを伸ばしていく。

日本・中国でイオン注入装置・スパッタ装置・エッチング装置のセットで拡販していく。

Si-IGBT についても、12 インチへのウェハーサイズアップを機に日本でもイオン注入装置を拡販、同時に中国ではスパッタ装置を拡販していく。

中国の Si-MOSFET は現地生産の価格競争力のある蒸着装置を引き続き拡販し、パワーデバイス全体として 3 年間で 23/6 期の 1.5 倍に成長する計画。

**11. パッケージングの成長戦略は？**

A: 半導体チップの微細化に限界がある中、さらなる半導体の処理能力向上と省エネ実現のため、パッケージング技術の進化が期待されている。ウェハーレベルパッケージ（WLP）では最先端プロセスに対応したアッシング装置に強み・実績がある。アッシング装置に加えてスパッタ装置も拡販していく。

また、半導体チップ同士を適切に配線することで能力向上が図れるパネルレベルパッケージ（PLP）投資が本格化する見通し。既に台湾・日本の主要メーカーにアッシング装置の実績があり、スパッタ装置もセットで拡販していく。

**12. EV バッテリー用両面蒸着巻取装置の成長戦略は？**

A: EV バッテリーの正極集電体で使用されているアルミ箔を両面蒸着膜に置き換えることにより、安全性向上と小型大容量化につながるため、EV バッテリー世界シェア約 6 割の中国が先行した形で、23/6 期は 70 億円以上受注しており、24/6 期は 170 億円程度を見込んでいる。

当社の蒸着巻取装置は従来から高性能な自動車用のフィルムキャパシタで 9 割以上のシェアを占めてきた。この技術力を生かして、プラスチックフィルムの両面に一括でかつ 1 回で膜厚の成膜が実現可能であり、またプラスチックフィルムは熱ダメージを受けやすいが、すぐれた徐熱技術により高品質の両面蒸着膜を実現できており、他社との差別化が図られている。

高いシェアを確保しながら、さらに量産性を向上し差別化を図り、26/6 期には 300 億円を超えるビジネスにしていく。

## 【23/6期実績】

### 13. 3Q修正予想に対して、受注高・売上高・営業利益の増減要因は？

A: 受注高はほぼ予想どおりだった。

売上高は2,275億円となり、予想より125億円上振れた。3Q修正開示時に工事進行やコンポーネントの受注等を堅めに見込んでいたこと、為替の影響による。

営業利益は199億円と24億円上振れたが、為替の影響で売上が増加した中に低採算の案件が多かったことなどにより、営業利益の上振れ幅は限定的だった。

### 14. 半導体・電子、FPDの受注高・売上高の23/6期実績の分野別の内訳割合は？

A: 別紙の通り

### 15. 23/6期実績の品目別の利益の順位は？

A: 別紙の通り

## 【24/6期連結業績予想】

### 16. 24/6下期から売上高・営業利益が大きく改善するのはなぜか？

A: 半導体の本格回復を下期に見込んでいること、バッテリー関連の売上寄与が下期に高まることなどから、下期の売上高が増加する見込みとなっている。

期初受注残高1,410億円は部品長納期化の影響を受けた低利益率案件が中心であり、上期の売上貢献が大きく、下期にかけて受注残高の売上貢献が低下するとともに利益率は段階的に改善する。売上高増加効果も加わり、下期の営業利益の改善を見込む。

### 17. 24/6期1Qの売上高・営業利益はどのように見込んでいるのか？四半期ごとに見ると24/6期の売上高・利益率はどのように推移すると計画しているのか？

A: 一部23/6期4Qに前倒しで売上貢献した案件もあり、今期1Qの売上高は低い水準からのスタートとなり、営業利益も同様の見込み。

四半期毎に見ると、売上・利益率ともに段階的に改善していく。特に利益率は、売上増加の効果と部品長納期化の影響が残る期初受注残高の売上貢献が段階的に低下することによる改善効果で徐々に改善していく。

### 18. 半導体・電子、FPDの受注高・売上高の2024年6月期計画の分野別の内訳割合は？

A: 別紙の通り

以上

(別紙) 23/6期実績 品目別内訳割合・営業利益率順位

●受注高 品目別の内訳割合

受注高	23/6期 通期実績
<b>半導体電子 (億円)</b>	<b>869</b>
・メモリ	1割半ば
・ロジック	2割強
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	3割強
・実装	数%
・その他	-
<b>FPD (億円)</b>	<b>536</b>
・LCD	4割強
・OLED	3割半ば
・その他	2割強

●売上高 品目別の内訳割合

売上高	23/6期 通期実績
<b>半導体電子 (億円)</b>	<b>777</b>
・メモリ	2割半ば
・ロジック	2割弱
・電子部品	3割弱
・パワー半導体	2割半ば
・実装	一桁台半ば
・その他	-
<b>FPD (億円)</b>	<b>528</b>
・LCD	4割弱
・OLED	5割弱
・その他	1割強

●営業利益率順位 23/6期 通期実績

順位	品目
1	コンポーネント
2	半導体電子
3	その他
4	一般産業
5	材料
6	FPD

全社平均利益率は  
 3) その他と  
 4) 一般産業との間

## 24/6期計画 品目別内訳割合

### ●受注高

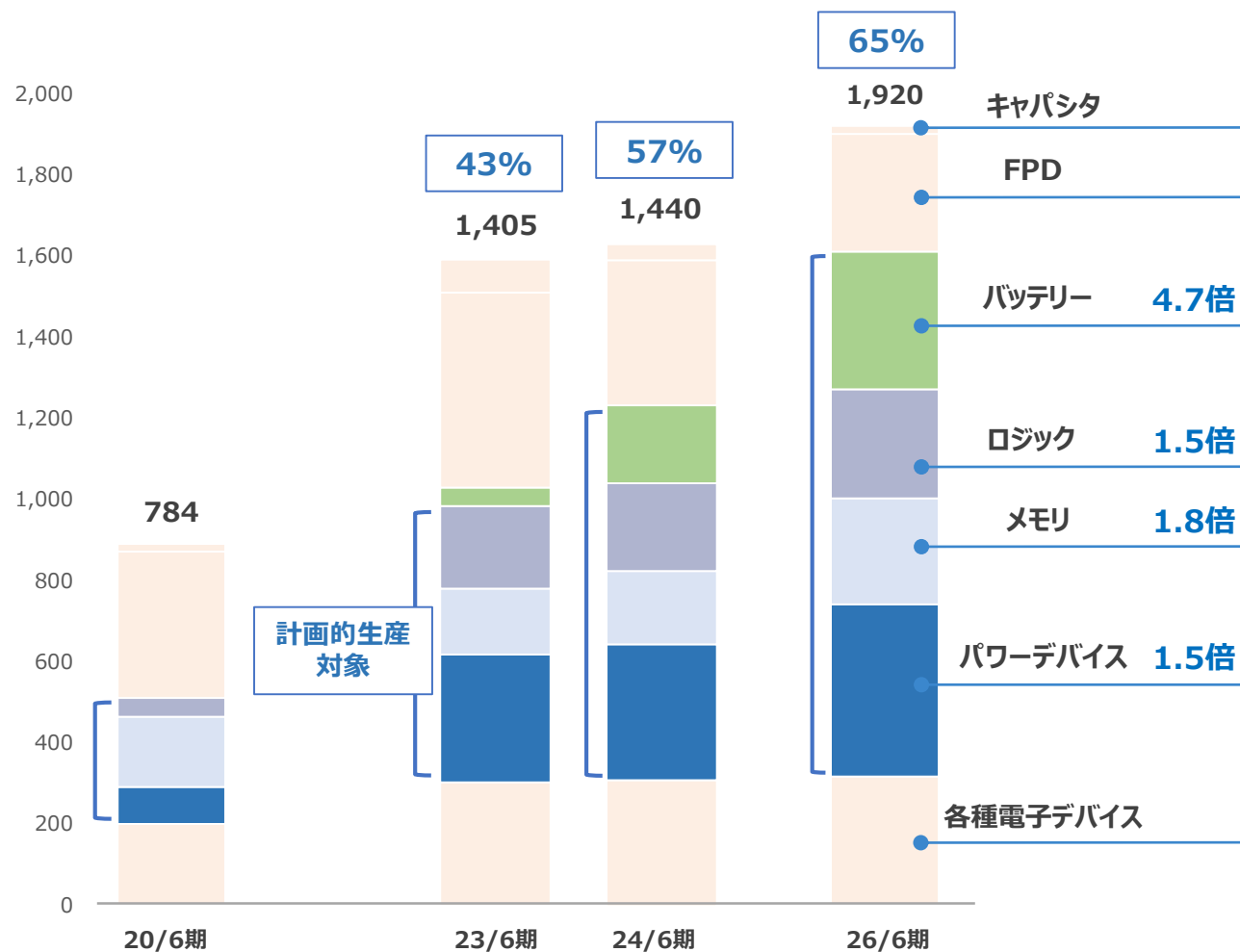
受注高	24/6期 通期計画
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>920</b>
・メモリ	2割弱
・ロジック	2割強
・電子部品	2割半ば
・パワー半導体	3割強
・実装	一桁台半ば
・その他	-
<b>FPD（億円）</b>	<b>520</b>
・LCD	約2割
・OLED	約4割
・その他	4割弱

### ●売上高

売上高	24/6期 通期計画
<b>半導体電子（億円）</b>	<b>935</b>
・メモリ	2割弱
・ロジック	約2割
・電子部品	2割強
・パワー半導体	3割強
・実装	一桁台半ば
・その他	-
<b>FPD（億円）</b>	<b>525</b>
・LCD	3割半ば
・OLED	3割弱
・その他	4割弱

## 計画的生産対象製品の拡大

【単位：億円】



### 【20/6期】

- ロジック・メモリ：190億円前後
  - パワーデバイス：80億円程度
- ⇒ 計画的生産が難しい規模

### 【23/6期】

- ロジック・メモリ：320億円強
  - パワーデバイス：280億円弱
- ⇒ 計画的生産できる規模に成長

### 【26/6期】

- ロジック・メモリ：500億円超
  - パワーデバイス：400億円超
  - バッテリー：300億円超
- ⇒ 計画的生産対象製品は半導体・電子・FPD事業全体の  
**65%**まで高まる見込